

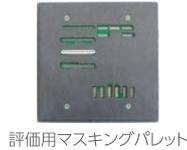
JS-E-15L

マスキングパレット洗浄性を向上し、治具メンテナンスをより容易に
マスキングパレット洗浄対応ポストフラックス

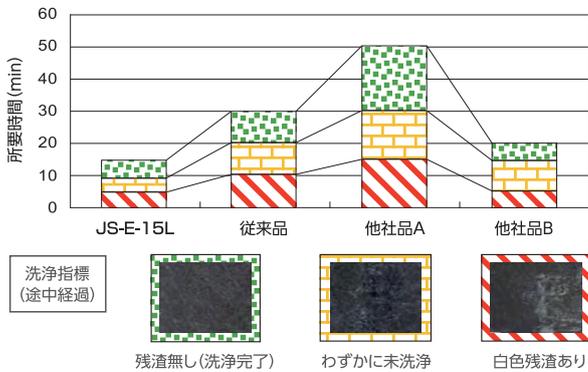
優れたパレット洗浄性で作業時間を半減

■ マスキングパレット洗浄試験

- 塗布量：固形分膜厚 10 μm
- 予熱温度：105°C（昇温時間：80sec）基板はんだ付け面
- はんだ：Sn 3.0Ag 0.5Cu（温度：255°C ± 2°C）
- はんだ付け回数：30回（インターバル：6分毎）
- 洗浄方式：2-プロパノール浸漬
（硬質ナイロンブラシ、金属へら併用）
※試験例であり、推奨条件ではありません。



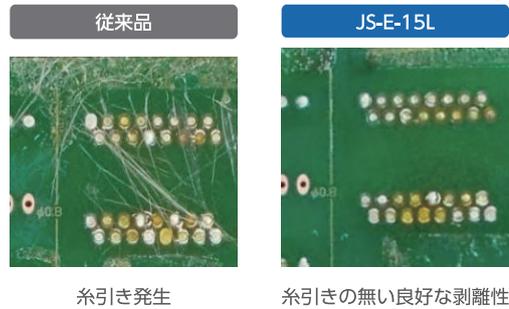
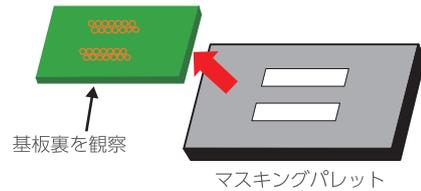
●マスキングパレット洗浄所要時間



パレットへの残渣付着を軽減

■ マスキングパレット剥離試験

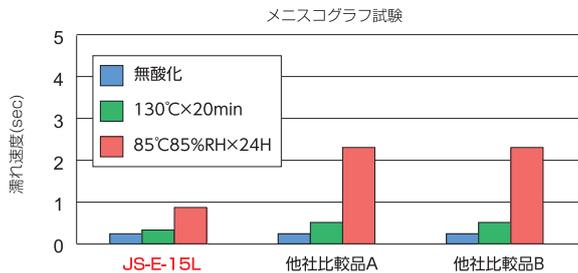
- 10回連続はんだ付け後、90°Cでパレットからの剥離状態



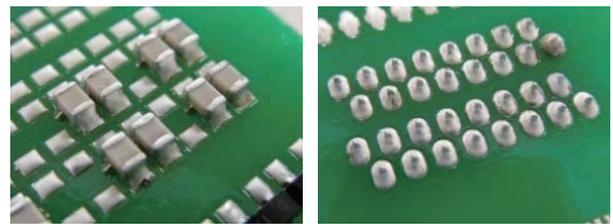
部品への高い濡れ性、さらにはんだボール抑制、はんだ切れも向上

■ 酸化黄銅への濡れ性比較

- 酸化処理: 130°C20min、85°C85%RH24h
- はんだ種類: Sn 3.0Ag 0.5Cu
- はんだ温度: 250 ± 2°C



■ 各部品はんだ付け状態



チップ周辺のハンダボールや、コネクタでのブリッジ・ツララの発生を防止

● 製品物性表

製品名	JS-E-15L
固形分含有量 (%)	15.0
比重 (at20°C)	0.823
ハライド含有量 (%)	0.063
フラックスタイプ	ROL1
適用塗布方法	スプレー/発泡
使用用途	フローはんだ付け

マスキングパレット洗浄対応	優れたスルーホールアップ
高濡れ	ブリッジ抑制
部分ディップ対応	ハンダボール抑制
対応合金: Sn/Ag/Cu系, Sn/Cu系	無洗浄タイプ No-clean